

回路実装基板の創成と個片化技術

現在、わが国において、高性能を有する、多くの種類の半導体が開発されている。これは、ひとえに、わが国の半導体工学の発展によるものである。高耐熱基板や半導体を製造する技術には、高度な材料加工技術が必要であり、半導体工学の発展に大きな貢献をしているのは、周知の事実である。そこで今回の研究会においては、高放熱基板や半導体加工に必要な付加加工(めっき、印刷)、除去加工(切断)等に焦点を当てた。これらの関連技術および加工法の原理、特徴、加工事例等に関して、4件のご講演を頂く。

主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2025年10月17日(金) 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。

日本大学 理工学部 駿河台キャンパス

1号館 3階 134教室

当日連絡先：03-3259-0404

URL：<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>

※ 講演者には開催前の状況により、対面か Web のどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。



13:00～13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05～13:55	講演1 パワーデバイス用半導体、セラミックス基板および個片化加工技術	(株)クマクラ 牛房 信之 氏, 熊倉 賢一 氏
13:55～14:45	講演2 セラミックス基板へのめっきによるパターン創成技術	EBINAX(株) 渡邊 健治 氏
14:45～15:05	<休 憩>	
15:05～15:55	講演3 セラミックス基板への銅パターン厚盛印刷技術	ニューロン精工精密工業(株) 村山 邦夫 氏
15:55～16:45	講演4 粒子配向制御による有機無機複合材の高熱伝導化技術	デンカ(株) 宮田 建治 氏
16:45～16:55	閉会挨拶・事務連絡	
17:10～19:10	技術交流会 タワー・スコラ 1F カフェ	

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（税抜額 14,000 円＋消費税 1,400 円），非会員アカデミア：6,600 円（税抜額 6,000 円＋消費税 600 円），学生：無料

※会員は 5 人／社まで、非会員は 2 人／社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（税抜額 4,500 円＋消費税 450 円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

申込締切日：2025 年 10 月 2 日(木)

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会事務局

・FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>